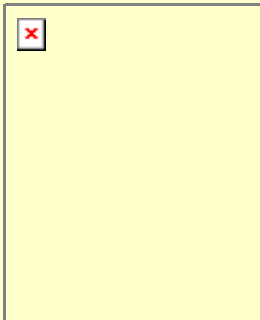


本期封面



1999年4

栏目:

DOI:

论文题目: 晶须增强CMCs的增韧机制及其角度依赖性

作者姓名: 翟洪祥, 黄勇, 汪长安

工作单位: 北方交通大学, 清华大学

通信作者: 翟洪祥

通信作者Email:

文章摘要: 探讨了晶须增强陶瓷基复合材料(CMCs)增韧过程的主要机制, 研究了机制的发生和作用过程对晶须角度的依赖性. 结果表明, 大部分晶须在架桥过程中折断, 折断后的晶须可以滑动摩擦的形式继续消耗能量. 当晶须角度较大时, 架桥过程和滑动摩擦过程因局部基体的破碎而截止.

关键词: 增韧机制; 角度效应; 晶须架桥; 滑动摩擦; 基体

分类号:

关闭